

节次/星期		星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
上午	1	功率集成电路 [01] 张骥 29 1-6周,8-17周,星期1,1-2节,B-406		微电子封装技术 [01] 包军林 58 1-5周,7-9周,星期3,1-2节,B-606	有机半导体材料与器件 [01] 常晶晶,林珍华 98 1-5周,7-17周,星期4,1-2节,B-422	半导体光电子器件 [02] 胡辉勇 15 1-2周,4-5周,7-10周,星期5,1-2节,B-605		
	2							
	3	专用集成电路设计(研讨课) [01] 张骥 34 1-6周,8-13周,星期1,3-4节,B-406	形势与政策(VII) [04] 王猛 96 7-8周,星期2,3-4节,B-606	半导体传感器与MEMS技术 [01] 娄利飞 84 1-5周,7-9周,星期3,3-4节,B-606	集成电路可靠性 [02] 刘红侠,刘莉 22 1-5周,7-9周,星期4,3-4节,C-123	微电子封装技术 [01] 包军林 58 1-2周,4-5周,7-10周,星期5,3-4节,B-606		
	4							
下午	5	半导体传感器与MEMS技术 [01] 娄利飞 84 1-6周,8-9周,星期1,5-6节,B-606	集成电路可靠性 [02] 刘红侠,刘莉 22 1-5周,7-9周,星期2,5-6节,C-123	专业教育(IV) [02] 蔡觉平 236 4-5周,星期3,5-6节,B-529	嵌入式系统设计 [01] 李康 55 1-5周,7-13周,星期4,5-6节,B-606	集成电路测试技术 [01] 张弘 99 1周,5-11周(单),星期5,5-6节,B-605		
	6							
	7	集成电路新技术讲座 [01] 马晓华 85 5-6周,8-13周,星期1,7-8节,B-516	半导体光电子器件 [02] 胡辉勇 15 1-5周,7-9周,星期2,7-8节,B-605		集成电路测试技术 [01] 张弘 99 1-5周,7-12周,星期4,7-8节,B-605			
晚上	8							
	9							
	10							